

MS9000-SA0型 ワイドボトムヒータ(オプション)

300Dx450Wmm広範囲に均一加熱するIR式ヒータ。

大型基板で熱負荷の大きな基板を容易にプリヒートします。

温度プロファイル制御装置に連動して加熱します。

3ブロックに分けて制御できます。(不要な加熱ゾーンをOFFに出来ます)。

ワイドボトムヒータ装置の概要

IR型ヒータ素子を4本ずつ、センター部をメインとして、左右の合計3ブロックで総計12本配置し、広範囲で均一な加熱を行います。



ワイドボトムヒータ(MS9000SA0)

加熱力: 中心部=1KVA / 左=1KVA / 右=1KVA

熱エリア: 中心部 300Dx150W / 左 300D x 150W / 右 300D x 150Wmmk



基板アンダーサポートピン

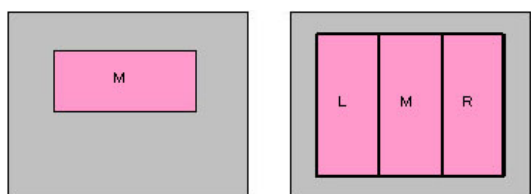
標準装備(2本のレールと4本のピンが含まれます)



基板上側反り防止ピン

オプション MSC-01ARP (2本のレールと4本のピンで構成されます)

熱エリア



ヒータの配置: 標準ボトムヒータ / ワイドボトムヒータ
ヒータのサイズ: 150x300mm / 300 x 450mm



ワイドボトムヒータ制御画面
タッチパネル上でON-OFF

中心部と左右3ブロックのボトムヒータは、LとRの左右を制御画面上で、それぞれON-OFFすることが出来ます。基板の大きさや形状に合わせ、切り替えて使用することが出来ます。(中心部(Main)は常時ON)

リワーク作業では、加熱による基板の反りが、はんだ付け不良原因の一つとなり、基板のサイズが大きいほど、反りの発生が出やすくなります。出来るだけ基板全域での温度差を少なくすることで反りの発生を防ぐことが重要です。そのために大型基板ではワイドボトムヒータが不可欠となります、オプションの反り防止治具類は、可能な限り使用せずにリワーク作業が完了できるのが理想です。反り防止の最終的な手法として、オプションの反り防止用治具をご使用ください。但し、基板が最初から反っているような場合には、反り防止治具のご使用をお勧めします。